

上海剑桥科技股份有限公司
关于变更 H 股发售所得款项用途的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第三十七次会议及第五届董事会战略与 ESG 委员会第十五次会议，审议通过《关于变更 H 股发售所得款项用途的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更 H 股发售所得款项用途的基本情况

2025 年 10 月 28 日，公司首次发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易，本次发行 H 股股数为 67,010,500 股，发售价每股 68.88 港元，发售所得款项总额为约 4,615.7 百万港元，扣除相关开支后所得款项净额为约 4,480.0 百万港元。

2025 年 11 月 10 日，公司悉数行使 H 股超额配股权，新增发行 H 股股份 10,051,500 股，本次超额配售完成后，H 股总股数增至 77,062,000 股，发售价每股 68.88 港元，发售所得款项总额为约 692.3 百万港元，扣除相关开支后所得款项净额为约 677.1 百万港元。

发售所得款项总额合计为约 5,308.0 百万港元，扣除相关开支后所得款项净额合计为约 5,157.1 百万港元。

截至目前，本次拟变更 H 股发售所得款项用途的详情请见下表：

单位：百万港元

计划用途	H 股招股章程所披露的拟定使用金额	截至本公告日期的预估已使用金额	截至本公告日期的预估未使用金额	变更 H 股发售所得款项用途的拟定使用金额	未使用金额拟定使用时间表
提升公司在光模块、宽带及无线产品方面的产能					
关于公司的宽带产品，包括 50G/25GPON 产品	618.9	11.5	607.4	-	2027 年底前
关于公司的无线产	670.4	2.4	668.0	-	2027 年底前

品，包括 Wi-Fi 7 及 Wi-Fi 8 产品					
关于公司的光模块产品，包括 800G/1.6T 产品	1,289.3	1,289.3	-	1,768.5	2027 年底前
提升公司的研发人才及技术，以实现更多突破					
招聘研发人才	283.6	19.5	264.1	88.0	2030 年底前
升级机器及软件以支持研发工作	489.9	489.9	-	-	2030 年底前
用于支持研发工作的材料	257.9	24.7	233.2	77.7	2030 年底前
加强业务推广及营销力度					
招聘销售及营销人才	242.4	-	242.4	80.8	2030 年底前
行业协会及全球活动	15.4	0.4	15.0	15.0	2030 年底前
战略投资	773.6	773.6	-	-	2030 年底前
运营资金	515.7	515.7	-	-	不适用
总计	5,157.1	3,127.0	2,030.1	2,030.1	

注：若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

本次变更 H 股发售所得款项用途完成后，所有原定用于提升宽带产品和无线产品方面的产能的余额 1,275.4 百万港元，及部分原定用于提升研发能力及加强市场扩展和营销活动的余额 493.1 百万港元，合计 1,768.5 百万港元，将用于提升光模块产品方面的产能，包括但不限于扩张光模块产能所需的生产机器、设备及原材料，对现有设备进行升级改造，特别是提升生产流程全自动化水平。除此以外，余下尚未使用所得款项净额的用途不变。

二、内部决策程序

公司于 2026 年 10 月 23 日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第三十七次会议的通知，并于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。全体董事参加表决，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。全体董事一致审议通过《关于变更 H 股发售所得款项用途的议案》，同意公司本次变更 H 股发售所得款项用途事项。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第十五次会议审议通过了上述议案，全体委员一致同意上述议案。

三、H 股上市以来的业务进展

自公司 H 股于 2025 年 10 月上市至今，公司经营业绩保持快速增长。其中，2026 年第三季度实现营业收入 22.16 亿元，同比增长 67.26%；前三季度累计实

现营业收入 49.21 亿元，同比增长 46.46%，已超过上年全年水平。第三季度，归属于上市公司股东的净利润 4.33 亿元，同比增长 212.81%；前三季度累计实现归母净利润 7.61 亿元，同比增长 193.35%。

公司业绩的增长主要受益于全球人工智能（AI）基础设施建设带动的高速光模块需求增长，以及公司在客户拓展、产能建设和供应链保障等方面取得的积极进展。特别是北美市场新客户拓展取得重要突破，客户结构由以网络设备供应商为主，逐步拓展至传统云服务商、新兴云计算及算力基础设施服务商等不同类型客户，进一步拓宽了市场空间，增强了业务增长的持续性。

得益于营业收入规模扩大及盈利能力较高的高速光模块业务占比持续提升，公司盈利能力增长更加明显。尽管 DDR 等关键物料价格上涨及供应紧张对传统宽带和无线接入业务毛利率造成一定压力，高速光模块业务的快速发展仍推动公司整体盈利能力显著提升。截至 2026 年第三季度，高速光模块业务收入占公司营业收入的比例已超过 50%，其中 800G 产品占高速光模块出货量的绝大部分。公司高速光模块业务的快速发展，是行业需求增长与公司在客户拓展、产能建设、供应链协同及技术研发等方面持续投入共同作用的结果。

（一）持续拓展客户群体，推动业务结构优化

随着 AI 基础设施投资持续增长，全球高速光模块市场需求保持较快增长，主要客户更加重视供应商多元化、技术能力、规模化交付及供应链安全，为具备综合竞争力的新供应商创造了市场机会。

公司积极把握行业机遇，在巩固现有客户合作的同时，持续拓展北美及其他重点市场。今年以来，公司成功导入传统云服务商和新兴云计算服务商等新客户，并积极推进与其他云服务商、网络设备供应商、算力基础设施及芯片相关企业的技术交流、产品验证和业务合作。客户群体的持续拓展为公司业务增长提供了支持，也进一步增强了客户结构的多元化和长期成长潜力。

（二）持续扩大产能规模，提升全球化交付能力

规模化制造和稳定交付能力已成为客户选择高速光模块供应商的重要因素。H 股上市以来，公司持续推进产能建设，提升制造、工艺管理及交付保障能力。截至 2026 年 9 月初，公司已基本形成月设计产能约 100 万支的生产能力，为现有客户需求增长及新客户导入提供了支持。

公司持续加强与主要客户的中长期需求沟通，结合行业趋势、客户需求及供应链配套情况规划未来产能，计划在未来约 15 个月继续推进产能大幅扩张，并

根据市场需求、客户合作进展及关键物料和设备供应情况动态调整扩产节奏。

同时，公司持续完善全球化制造和交付体系，综合不同生产基地在成本、人才、工艺及供应链等方面的优势，优化产能布局和资源配置，为客户提供灵活、稳定的交付方案，提升全球供应链的安全性和韧性。

（三）加强上游供应链协同，构建差异化竞争优势

关键元器件、原材料及生产设备的供应保障能力，已成为影响高速光模块行业产能扩张和产品交付的重要因素，也是客户评估供应商综合竞争力的重要考量。

公司持续深化与上游核心供应商的战略合作，通过股权投资、固定资产及产能配套、长期采购、预付款等多种方式，加强激光器、硅光芯片、PCB 等关键器件和材料，以及自动化生产设备的供应保障，提升供应链协同与垂直整合能力。

同时，公司通过与专业投资机构合作，利用产业基金等方式参与新材料、新工艺和新技术的早期研发及产业化，为未来技术迭代和产品升级储备资源。依托全球化运营和交付体系，公司积极推动核心供应商的海外生产及本地化交付布局，提升供应链多元化、稳定性和抗风险能力。

围绕关键材料、核心器件、生产设备及全球制造体系形成的供应链协同能力，正在逐步成为公司参与全球高速光模块市场竞争的重要优势。

（四）持续加强技术研发和全球客户支持，推动新产品及新技术布局

公司持续强化研发体系和全球客户技术支持能力。依托美国硅谷、日本东京、上海、新竹等地的研发资源，加强跨区域协同，建立覆盖主要客户的全天候技术支持和响应体系，提升客户需求响应、产品验证及联合开发效率。

在下一代高速光互联技术领域，公司持续推进近封装光学（NPO）、薄膜铌酸锂（TFLN）调制技术，以及 USFP、XPO 等新型高密度可插拔光模块相关技术和产品研发，推动与更多客户开展技术交流、产品验证及联合开发，为未来产品迭代和业务拓展创造条件。

通过持续提升研发、制造、供应链及全球技术服务能力，公司正由以产品制造和交付为主的供应商，逐步向具备综合能力的合作伙伴发展，进一步提升在全球高速光互联产业链中的竞争地位。

（五）充分利用资本市场融资平台，支持主营业务发展

公司始终围绕主营业务发展需求开展资本配置，积极利用境内外资本市场支持研发投入、产能建设和供应链配套。公司通过香港首次公开发行、股份配售及可转换债券等方式筹集资金，为高速光模块扩产、全球化生产布局及关键供应链

保障提供支持。

公司将继续以主营业务发展为中心，统筹业务增长、资本开支、供应链安全及资金使用效率，提升资本配置能力，为中长期发展创造条件。

（六）未来经营展望

随着全球 AI 基础设施持续建设、数据中心网络架构演进及高速光互联技术升级，公司认为高速光模块及相关产品仍具有较好的中长期市场发展空间。目前客户需求保持较高水平，行业产能及关键供应链配套能力持续扩张，未来供需关系也可能随着新增产能释放、技术演进及市场竞争变化而调整。

公司将密切关注市场需求、客户合作、技术迭代及供应链变化，持续推进产能建设、技术研发、客户拓展和全球化供应链布局，提升产品竞争力、规模化交付能力及经营效率。

公司继续聚焦主营业务，以客户需求为导向，以技术创新、供应链协同和全球化交付能力为支撑，不断提升全球高速光互联市场竞争地位，推动高质量、可持续发展，为股东、客户、员工及合作伙伴创造长期价值。

四、变更 H 股发售所得款项用途的原因

H 股招股章程所披露发售所得款项的计划用途是基于公司于招股章程披露时对当时及未来的市场状况作出的预测而制定。董事会需要对全球及国内经济状况的发展趋势、公司所在行业的变化趋势、公司自身业务发展进程等进行动态评估，以确定 H 股发售所得款项净额最为有效的用途。

截至本公告日期，H 股发售所得款项中分配至提升在光模块产品（包括 800G/1.6T 产品）方面的产能的未使用金额余额为零，显示出较先前于招股章程所披露者更快的使用率。该使用效率的提升主要受下游客户及消费者需求显著上升趋势推动，导致本公司于 2026 年加速光模块产品的产能建设：（1）资本开支持续增长；（2）上调采购计划；及（3）终端需求转向推理。上述因素共同推动本公司客户对高速光模块产品（如 800G、1.6T 及 NPO 产品）的需求，进一步推动本公司光模块产品相关产能的扩充。

与此同时，随着 AI 算力需求的持续爆发式增长，高速光模块需求继续保持强劲。随着公司光模块业务比重的持续提升，以及近期新客户拓展方面的进展，考虑到公司现有订单增长速度高于公司产能增长，公司亟需加快光模块产品的产能扩张和供应链开拓，以满足客户的交付需求。

根据 2025 年年度股东会批准的一般性授权，公司已分别于 2026 年 5 月配售

新 H 股和 2026 年 10 月配售新 H 股及发行可转换债券，以更多融资支持光模块业务的供应链保障和产能扩张计划。尽管如此，结合公司实际经营情况及发展规划，经测算仍需要投入更多资金用于补充公司对光模块产品相关产能扩充的投资。

另一方面，2025 年年底至今，宽带和无线接入市场受 DDR 等核心物料价格上涨及供应短缺的影响，客户购买力下降，采购需求延迟。相应的，公司原定对宽带及无线产品的产能扩张的紧迫性有所下降。经评估，使用除 H 股发售所得款项以外的自有和自筹资金已经可满足公司今年及 2027 年在宽带和无线产品方面的产能和业务需求。

此外，部分原定用于提升研发能力及加强市场扩展和营销活动的 H 股发售所得款项计划于 2030 年前使用完毕，相较于扩产，其相对的使用周期较长，使用效率偏低，回报周期较长。而随着公司产能和交付的快速提升，公司盈利能力也快速大幅提升，未来研发和市场相关的投入有望通过新增利润等自有资金以及其他自筹资金满足。

基于上述原因，通过变更 H 股发售所得款项用途，将原定用于宽带和无线接入产品扩展产能的资金，以及部分原定用于提升研发能力及加强市场扩展和营销活动的资金，变更为用于光模块产能扩张，有助于抓住 AI 硬件需求的窗口期，加快提升业务规模和盈利能力，可以有效提升公司 H 股发售所得款项的使用效率，持续巩固公司可持续发展及加快推进公司全球化战略，优化对公司股东的投资回报。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第五届董事会战略与 ESG 委员会第十五次会议决议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 31 日